



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110426000A
2012 年 3 月 26 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

AMKOR社製造 PBGAパッケージ 一部製品 代替Substrate部材追加取消のご案内

(初版 PCN20110426000 2011 年 4 月 29 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更取消についての連絡になります。本変更は実施されません。詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。お客様の受領連絡は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	初版連絡の下記変更内容について変更取消の連絡になります。 AMKOR 社製造 PBGA パッケージ 一部製品 代替 Substrate 部材追加 現行 : 認定 Substrate 変更後 : 認定 Substrate, Doosan 社製 Substrate			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	—			
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：今回のお知らせは、2011年4月29日発行 初版 PCN20110426000にて連絡しました下記変更について、変更取消の連絡になります。現行の部材供給業者復旧のため、本変更実施を取り消します。今後、本変更部材供給業者も含め新規部材供給業者を使用する際には、新規PCNにて、信頼性試験計画及びサンプル提供と共に別途お知らせいたします。

AMKOR社サイト製造 PBGAパッケージ 一部製品について、震災状況下での供給能力確保の為、代替 Substrate部材追加の連絡になります。一部部材の供給制限のため、認定試験終了次第、本代替部材の追加変更は直ちに実施予定です。認定終了前のいかなる製品出荷についても、事前顧客承認が必要になります。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

Substrate 部材

現行

認定 Substrate

変更後

認定 Substrate
Doosan 社製 Substrate

理由：供給能力確保の為

製品表示

この変更による製品捺印、出荷ラベルの変更はありません。部材識別については、弊社標準のロット追跡及び製造手順によりトレーサビリティは確保されます。

対象製品リスト

対象製品名				
AFE84061ZDQ	GC4116-PB	TMS320C44GFW50	TMS320F28335ZJZA	TNETV2021AFNBZDS
GC2011A-PB	GC5016-PB	TMS320C6211BGFN150	TMS320F28335ZJZS	TVP9001ZDS
GC4016-PB	GC5016-PBZ	TMS320C6211BZFN150	TNETV2020AGDS	
GC4016-PBZ	TLK3114SCGNT	TMS320F28234ZJZS	TNETV2020AZDS	

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 9 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	GC5316IZED/ F711298GFT		Substrate:	Doosan Substrate
Package:	PBGA		Site(s):	Amkor
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration			Sample Size
Material Property Comparison	Specification Review			per spec
Preconditioning	JEDEC L-4/260C			539
High Temperature Storage Life	150C, 600hrs Note (1)			45
Temperature Cycle	-55C/125C, 1000cyc			231
Temperature Humidity Bias	85C/85%RH, 600hrs Note(1)			77
UnBiased HAST	130C/85%RH, 96hrs			231
Note (1): Qualification Device release at 600hrs, other device Qual by Similarity/Bridge at 1000hrs				